

» For Immediate Release «

Aaeon, Adlink, Advantech und Kontron veröffentlichen gemeinsam die Spezifikation nanoETXexpress 1.0

Kleiner COM Express™ Typ 1 Formfaktor startet durch



Daniel Chao
(Director of Hardware
Development, AAEON)

Wolfgang Heinz-Fischer
(Marketing Director,
Advantech Europe)

Alice Chien
(Embedded Platform
Project Manager, Adlink)

Dirk Fintel
(CTO, Kontron)

Eching/Nürnberg, Deutschland, 3. März 2009: Der von Kontron initiierte scheckkartengroße Computer-on-Modules Formfaktor [nanoETXexpress](#) (84 mm x 55 mm) startet durch und gewinnt zunehmend Marktakzeptanz: Auf der Embedded World in Nürnberg haben die Embedded Computer-on-Modules Hersteller Aaeon, Adlink, Advantech und Kontron gemeinsam die Revision 1.0 der [nanoETXexpress Spezifikation](#) verabschiedet, die jetzt auch SDVO unterstützt. Darüber hinaus werden sie gemeinsam dem PICMG® Konsortium den nanoETXexpress Formfaktor mit dem neutralen Namensvorschlag „Ultra“ vorstellen, damit er in eine der nächsten COM Express™ Spezifikationen aufgenommen werden kann.

Zukunftssichere Designs, maximale Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit sind nur einige der vielen high-quality Features des nanoETXexpress Formfaktors. Sie haben Aaeon, Adlink, Advantech und Kontron inspiriert, zusammen an der Revision 1.0 zu arbeiten und – neben dem etwas größeren Formfaktor “Compact” (95 x 95mm) – die Aufnahme des “Ultra” Formfaktors in die COM Express™

Spezifikation voranzutreiben. Aktuell umfasst die COM Express™ Spezifikation nur die Abmaße "Basic" (95 x 125mm) und "Extended" (110 x 155mm).

"Wir unterstützen den Formfaktor "Ultra", da er perfekt in unser Produktportfolio passt. Wir haben den Intel® Atom™ Prozessor bereits in unser COM-U15 COM Express™ Computer-on-Module integriert. Der Schritt, ihn auch in das nanoCOM-U15 zu integrieren war deshalb leicht", erklärt der bei Aaeon für Computer-on-Modules verantwortliche Product Manager ECD Peter Yang.

"Im Markt der Computer-on-Modules orientierten Designs sehen wir, dass Kunden eine klare Präferenz zu einem einzigen offenen Standard entwickeln: PICMG® COM Express™. Dadurch, dass wir den neuen "Ultra" kleinen Formfaktor anbieten, der völlig Pin- und Signal kompatibel zur PICMG® COM Express™ Typ 1 Spezifikation ist, können wir den Erfolg von COM Express™ fortschreiben und dieses bestehende Design-Ecosystem und dessen Sicherheit nutzen. Die COM Express™ kompatiblen Connectoren mit hoher EMV machen den "Ultra"-Formfaktor folgerichtig zu einem zukunftssicheren Design für den Markt der Small Form Factor Computer-on-Modules", sagt Henk van Bremen, Product Director der Adlink Embedded Division.

"Da der Formfaktor "Ultra" zu 100 Prozent auf der etablierten COM Express™ Typ 1 Spezifikation basiert, was die Pinouts und die Connector-Position betrifft, ist die Entwicklung von Small Form Factor Computer-on-Modules analog der COM Express™ Spezifikation das sicherste Langzeit-Investment", stellt Aaron Su, Product Manager von Advantech, fest.

"Der Support von drei weiteren bedeutenden Computer-on-Modules Herstellern unterstreicht die Tatsache, dass nanoETXexpress ein besonders sicheres Investment ist. Auch ist der Markt für COM Express™ Type 1 Module besonders stark, denn VDC prognostiziert bis 2010 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 70 Prozent. Deshalb erwarten wir auch, dass die "Ultra"-Spezifikation für kreditkartengroße Computer-on-Modules zum de facto Standard für Computer-on-Modules basierte Small Form Factor Design wird", erklärt Dirk Finstel, CTO von Kontron.

nanoETXexpress Computer-on-Modules unterstützen jetzt SDVO

Die neue SDVO Schnittstelle macht die kleinen nanoETXexpress Computer-on-Modules hinsichtlich der Grafikunterstützung besonders flexibel und kosteneffizient: Die Revision 1.0 der nanoETXexpress Computer-on-Modules Spezifikation macht SDVO über einen separaten Flatfoil-Connector verfügbar. Damit kann der LVDS Support über den COM Express™ Connector erhalten bleiben und neben DVI weiter genutzt werden, was auch Lösungen mit zwei unabhängigen Displays ermöglicht.

Die Revision 1.0 der nanoETXexpress Spezifikation steht unter <http://www.nanoetxexpress.com/> zum download bereit.

**Aaeon, Adlink, Advantech und Kontron
veröffentlichen gemeinsam die
Spezifikation nanoETXexpress 1.0**

Weitere Hersteller sind aufgerufen, Computer-on-Modules nach der zur Verabschiedung vorgeschlagenen COM Express™ "Ultra" Spezifikation zu entwickeln. Details zur Spezifikation unter <http://www.nanoetxexpress.com/specs/specs.php>.

###

About AAEON

AAEON Technology, established in 1992, develops, manufactures and markets a wide range of industrial computer solutions, embedded computer systems, BOX PCs, PC/104, Computer-on-Modules, medical PCs and more. AAEON has approx. 450 employees working in several offices around the world, including the USA, Europe, China and Singapore. We are committed to providing our customers with reliable, high quality embedded motherboards, panel PCs, medical PCs, industrial PCs, Computer-on-Modules and the necessary accessories for turnkey systems. Our tailor made OEM/ODM solutions are valued by our long-term and renowned customers who receive exactly the right custom-designed IPC solution for their projects. Our large OEM/ODM customers thereby play a central role in our worldwide growth. For more information, please visit:

<http://www.aaeon.com>

About ADLINK

ADLINK Technology provides a wide range of embedded computing products and services to the test & measurement, automation & process control, gaming, communications, medical, network security, and transportation industries. ADLINK products include PCI Express®-based data acquisition and I/O; vision and motion control; and AdvancedTCA, CompactPCI, and Computer-on-Modules (COMs) for industrial computing. With the acquisition of Ampro Computers, Inc., ADLINK also provides a wide range of Extreme Rugged and Rugged Single Board Computers, Computer-on-Modules and Systems under the brand name Ampro by ADLINK. ADLINK strives to minimize the total cost of ownership (TCO) of its customers by providing customization and system integration services, maintaining low manufacturing costs, and extending the lifecycle of its products. ADLINK is a global company with headquarters and manufacturing in Taiwan; R&D and integration in Taiwan, China, and the US; and an extensive network of worldwide sales and support offices. More information at: <http://www.adlinktech.com>

Über Advantech

Advantech bietet seit 1983 visionäre und zuverlässige Industrial Computing-Lösungen für Unternehmen und arbeitet eng mit seinen Partnern zusammen, um Komplettlösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen in verschiedenen Branchen zu entwickeln. Advantech bietet Produkte und Lösungen in drei Geschäftsbereichen: Embedded ePlatform, eServices & Applied Computing und Industrial Automation. Mit über 3400 engagierten Mitarbeitern sorgt Advantech für umfassenden Support und betreibt ein Vertriebs- und Marketingnetzwerk in 18 Ländern und 39 Großstädten, um Kunden weltweit Service mit kurzer Produkteinführungszeit zu bieten. Advantech ist ein Premier Member der Intel® Embedded and Communications Alliance, einer Gemeinschaft von Entwicklern und Lösungsanbietern im Embedded- und Kommunikationsbereich. (Unternehmenswebsite: www.advantech.com).

Über Kontron:

Kontron entwickelt und fertigt standardbasierte und rugged COTS sowie kundenspezifische Embedded und Kommunikations-Lösungen für OEMs, Systemintegratoren und Anwendungsanbieter in verschiedensten Marktsegmenten. Die Entwicklungs- und Fertigungsstandorte von Kontron in ganz Europa, Nordamerika und der asiatisch-pazifischen Region arbeiten mit einer globalen Vertriebs- und Supportorganisation zusammen, die den Kontron Kunden hilft, ihr Time-to-Market zu reduzieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das vielfältige Produktportfolio von Kontron umfasst: Boards und Mezzanine-Karten, Computer-On-Module, HMIs und Displays, Systeme und Fertigung nach Kundenwunsch. Kontron ist Premier Mitglied der Intel® Embedded and Communications Alliance. Das Unternehmen ist seit fünf Jahren in Folge VDC „Platinum Vendor“ für „Embedded Boards“. Kontron ist im deutschen TecDAX unter der Wertpapierkennung "KBC" gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.kontron.de>

**Aaeon, Adlink, Advantech und Kontron
veröffentlichen gemeinsam die
Spezifikation nanoETXexpress 1.0**

PR online: <http://de.kontron.com/unternehmen/news-events/aaeon+adlink+advantech+und+kontron+verffentlichen+gemeinsam+die+spezifikation+nanoetxexpress+10.3418.html>

Bei Veröffentlichung bitten wir um Zusendung je eines Belegexemplars an nachstehende Kontaktpersonen.

Kontakt details

Leserkontakt EMEA:

Kontron AG
Oskar-von-Miller-Straße 1
85386 Eching/München
Deutschland
Tel.: +49 (8165) 77-777
Fax: +49 (8165) 77 279
www.kontron.de
sales@kontron.com

Pressekontakt Kontron:

Norbert Hauser
Kontron AG
Oskar-von-Miller-Strasse 1 /
85386 Eching/Munich
Deutschland
Tel: +49 (8341) 803-0
Fax: +49 (8341) 803-499
norbert.hauser@kontron.com

Pressekontakt EMEA:

Michael Hennen
SAMS Network
Sales And Management Services
Zeichenstraße 29
52146 Würselen
Deutschland
Tel.: +49 (0)2405-45267-20
Fax: +49 (0)2405-45267-21
michael.hennen@sams-network.com

All rights reserved.

Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron AG.
DIMM-PC®, PISA®, ETX®, ETXexpress®, microETXexpress®, X-board®, DIMM-IO® and DIMM-BUS® are trademarks or registered trademarks of Kontron Embedded Modules GmbH.
Intel and Intel Atom are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries.
PICMG and COM Express are trademarks of the PCI Industrial Computers Manufacturers Group.
All other brand or product names are trademarks or registered trademarks or copyrights by their respective owners and are recognized.

All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Subject to change without notice. Information in this press release has been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies.